时代半导体周报 | “华为”禁令再度升级，国内半导体产业配套升级

时代商学院研究员 杨志鸿

【上周回顾】

一、 市场表现

上周（8 月 17—21 日）沪深 300 指数上涨 0.3%，A 股半导体指数（申万）下跌 4.2%，跑输沪深 300 指数 4.2 个百分点。在申万二级行业中，上周半导体板块排名倒数第 4。年初至今，半导体板块整体涨跌幅为 55.92%，在 104 个申万二级行业中排名第 12。

二、 行业要闻与政策动态

1.工信部：支持企业加大技术攻关力度，布局集成电路关键装备

8 月 19 日，工信部部长肖亚庆强调，要支持企业加大技术攻关力度，布局集成电路关键装备，加强生态合作，开展联合攻关、应用验证，掌握核心技术，丰富产品供给。支持企业持续研发新形态、新功能消费电子产品，培育新的消费增长点。加快推进企业在智能控制、智能制造等方面数字化转型。支持和鼓励外资企业发展，努力保持企业的产业链供应链稳定。

2.SIA：全面禁止向华为销售芯片将对美国半导体行业造成巨大破坏

美国当地时间 8 月 17 日，SIA 协会主席、首席执行官 John Neuffer 在《SIA Statement on Export Control Rule Changes》中指出，协会仍在研究相关的规则，但这样大规模限制商业芯片销售将会对美国半导体行业造成巨大的破坏。协会对于美国政府一改此前的立场感到惊讶和担忧，因为政府在维护国家安全之时，已无法尽量做到把对美国企业造成的伤害控制在有限范围内。

3.我国集体电路行业所需高纯度含氟电子气体实现国产化

8 月 17 日，国务院国资委发布消息显示，目前，中国化工黎明化工研究设计院高纯四氟化碳和六氟化硫的年产能可达 2000 吨，价格与进口同类产品相当，但性价比高，标志着我国极大规模集成电路行业所需高纯度含氟电子气体实现国产化。

4.上海临港新片区建设三年行动方案发布

8 月 20 日，上海临港新片区建设三年行动方案发布，方案重点包括：对符合条件的集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等关键领域，落实自设立之日起 5 年内减按 15%税率征收企业所得税的政策。大力发展数字经济，打响在线新经济品牌。

5.中国第一座 12 英寸车规级晶圆厂落户临港新片区

8 月 19 日下午，中国第一座 12 英寸车规级功率半导体自动化晶圆制造中心项目正式签约落户临港新片区。临港新片区 12 英寸车规级功率半导体动化晶圆制造中心是闻泰科技半导体业务实现 100 亿美元战略目标的第一步。（证券日报）

6.上海报业集团、临港新片区等共同发起众源文化产业投资基金二期

8 月 21 日，上海报业集团和临港新片区管委会签署投资合作框架协议，共同发起众源文化产业投资基金二期，围绕新型文化消费产业投资布局。本期基金目标规模不低于 30 亿元，将分别配置子基金投资、项目直投和并购整合型投资。上海报业集团所属众源资本是首个由国有文化传媒集团发起、市场化运作的产业投资平台。(财联社)

三、上周重要半导体公司动态

1.澜起科技：公司津逮®CPU 已与多家主流国产操作系统做了适配认证

8 月 21 日，科创板公司澜起科技在互动平台表示，公司是一家集成电路设计公司，并未参与国产操作系统的研发。但公司津逮®CPU 及其平台已与多家主流国产操作系统做了适配认证。（科创板日报）

2.长电科技：拟定增募资不超 50 亿元，用于集成电路封装模块项目等

8 月 20 日，长电科技披露 2020 年半年度报告，上半年实现营业收入 119.8 亿元，同比增长 49.84%；实现净利润 3.7 亿元，上年同期净亏损 2.6 亿元。基本每股收益 0.23 元。同日，长电科技发布非公开发行 A 股股票预案，拟定增募资不超过 50 亿元，用于年产 36 亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目、年产 100 亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目和偿还银行贷款及短期融资券。

3.紫光 5G 芯片研发项目年内开工，中欣晶圆项目年内完成

8 月 20 日，据杭州网报道，紫光股份有限公司 5G 网络应用关键芯片及设备产业化基地项目、富芯半导体模拟芯片项目在内的集成电路攻坚工程，在“2020 年必须开工项目”中。此外，中欣晶圆项目则为，在“2020 年必须完成项目”。（杭州网）

4.寒武纪：公司的终端智能处理器 IP 是公司自研的智能处理器核

8 月 20 日，科创板公司寒武纪在互动平台表示，目前公司的终端智能处理器 IP 是公司自研的智能处理器核。公司主要客户为芯片设计厂商、服务器厂商及有数据中心建设需求的客户，

并与国内多个行业的知名企业建立了战略合作关系。此外，公司与珠海市横琴新区管理委员会在横琴先进智能计算平台（二期）项目开展紧密合作，供货硬件设备、授权软件。（科创板日报）

5.北斗星通：22nm 芯片已经完成流片，28nm 目前订单比较充足

8 月 19 日，北斗星通在互动平台表示，22nm 芯片已经完成流片，28nm 已经量产有二年了，目前订单比较充足，22nm 的量产预计明年下半年，这二款芯片目前处于国际领先水平。（财联社）

【本周观察】

8 月 17 日，美国商务部工业和安全局再次宣布进一步收紧对华为的限制，同时将华为在全球 21 个国家的 38 家子公司列入“实体清单”。这是继 5 月 15 日对华为升级限制之后的进一步限制，此举堵住了华为外购芯片的路径，即将之前禁令中的“漏洞”补上，华为今后的道路或将更加艰难。

回看国内关于半导体的重大事件，值得关注的是 8 月 20 日，上海发布的临港新片区 3 年行动方案，该方案显示未来三年，临港新片区增加值年均增速达到 25%；累计完成工业总产值 6000 亿元。在智能汽车、集成电路、高端装备、生物医药等领域培育千亿级产业集群，新增重大科创平台、载体 20 个以上；金融支持实体经济资金达到 1500 亿元以上，城市功能加快完善。5G 网络实现基本全覆盖。

除此之外，临港新片区管委会近期还分别与上海集成电路产业投资基金（二期）、上海人工智能产业投资基金、上海生物医药产业股权投资基金、上海泓宇航空产业股权投资基金、众源文化产业投资基金（二期）、上海建银长三角战略新兴科创基金、上海航空科技产业投资基金、上海临港新片区科创产业股权投资基金等产业投资基金签署合作协议，以打通基金与新片区产业的双向合作机制，共同推动临港新片区重点产业领域高速发展。

据统计，这些引进的基金包括已落地基金的总资金规模达到 2396 亿元。当前，已落地上海临港新片区的企业包含了盛美半导体设备(上海)有限公司、上海上飞飞机装备制造有限公司及聚力成半导体（上海）有限公司等一大批知名高科技公司。

时代商学院认为，我国半导体产业的发展虽处于起步阶段，但当前政策的扶持及各基金的投资都力度空前，为其发展营造了绝好空间。近日，又有不少半导体公司取得了技术上的突破，都是行业发展路上的新成果。本月进一步的“卡脖子”又将倒逼国产替代化的加速，同时，下游厂商对国产设备厂商的相关设备开始批量采购。总体看来，本土半导体企业“危机并存”，加之近期华为启动了一项新计划，名叫“南泥湾计划”，后续值得期待。

【风险提示】

1.政策推进成都不及预期
2.下游需求不及预期
3.研发不及预期

【严正声明】本文（报告）基于已公开的资料信息撰写，文中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。文章版权归原作者及原出处所有，未经时代商学院授权，任何媒体、网站及其他公众平台不得引用、复制、转载、摘编或以其他任何方式使用上述内容。获得授权转载，仍须注明出处。（联系邮箱：TimesBusiness@163.com）